

【図3】

従来の他の異方導電性樹脂を用いた基板へのフレキシブル基板の実装工程図である。

【図4】

本発明の第2実施例を示す半導体素子の実装工程断面図である。

【図5】

本発明の第3実施例を示す半導体素子の実装工程断面図である。

【符号の説明】

- | | |
|----------------------|------------|
| 11, 31, 41 | 基板 |
| 12, 32, 42 | 基板配線 |
| 13, 33, 43 | 磁性膜 |
| 14, 36, 36', 46, 46' | 導電粒子 |
| 15, 47 | 半導体素子 |
| 16, 48 | 素子電極 |
| 17, 35 | 封止樹脂 |
| 34, 44 | 異方導電性樹脂 |
| 37 | フレキシブル基板 |
| 38 | フレキシブル基板配線 |
| 41 | ガラス基板 |
| 45 | 紫外線硬化樹脂 |